

附件 3

哈尔滨理工大学硕士专业学位研究生产业导师资格申请表

姓名	马鑫	性别	男	出生年月	1973.05	政治面貌	群众
		民族	汉	学历	研究生	学位	博士
工作单位		深圳市汉尔信电子科技有限公司					
专业技术职称		CTO 技术负责人		职务	董事长		
研究生培养基地名称							
申报专业学位类别、领域		材料科学与工程,材料与化工/电子封装关键材料及异质集成技术		研究方向	精密焊接, 电子封装		
职业资格证书							
联系电话		18504600136		E-mail	maxin@hoerson.com		
主要学习工作经历							
1989-1993 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院, 焊接系, 本科, 获学士学位 1993-2000 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院, 材料加工工程, 硕博连读, 获工学博士学位 1998.2-1998.12 国际交流学生, 日本广岛大学工学部弹塑性工学研究室 2000.7-2001.8 信息产业部电子第五研究所, 广州, 于分析研究中心任工程师 2001.9-2003.8 日本广岛大学 VBL(Venture Business Laboratory)及机械系统工程系 (Department of Mechanical System Engineering)博士后研究员 2003.9-2003.12 日本学术振兴会(Japan Society for the Promotion of Science, JSPS)外国人特别研究员, 工作于日本广岛大学工学部。任期本为 2 年, 但于 2003 年 12 月辞职回国 2004.1-2014.1 深圳市亿钺达工业有限公司, 先后任副总经理, 总经理 2014.2-至今 深圳市汉尔信电子科技有限公司 董事长							

从事领域与专业特长			
<p>专业领域：精密焊接及微纳连接，电子封装材料及可靠性。</p> <p>中国焊接学会“钎焊及特种连接委员会”副主任</p> <p>全国焊接标准化技术委员会纤焊分技术委员会(SAC/TC55/SC2)委员</p> <p>全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会(SAC/TC297)委员</p> <p>中国电子学会高级会员</p> <p>广东省电器电子产品绿色制造标准化技术委员会（GD/TC26）委员</p> <p>深圳市政协第五届委员会委员</p> <p>广东省青联第十届委员会委员</p> <p>深圳市青年科技人才协会会长</p> <p>深圳市宝安区首批高层次科技创新人才</p> <p>深圳市宝安区政府人才工作顾问</p> <p>深圳市宝安区博士联谊会副会长</p> <p>深圳市宝安区海归联谊会主席</p> <p>拥有 14 项已授权中国发明专利、21 项实用新型专利</p>			
主要业绩（论著、科研项目、科研成果、奖励等）			
名称	发表刊物、项目来源	时间	本人 位次

《电子组装中的无铅软钎焊技术》 Ag@Sn core-shell powder perform with a high re-melting temperature for high-temperature power devices packaging	哈尔滨工业大学出版社 Advanced Engineering Materials	2006年 2017	第一 第四
Solid state interfacial reaction of eutectic Sn3.5Ag and pure tin solder with polycrystalline Cu substrate	Journal of Materials Science	2014	第三
Cu6Sn5 precipitation during Sn-based solder/Cu joint solidification and its effects on the growth of interfacial intermetallic compounds	Journal of Alloys and Compounds	2014	第五
A study on relationship between orientation evolution and coarsening behavior of Cu6Sn5 grains formed on polycrystalline Cu substrate	Advanced Materials Research	2014	第二
Effect of grain orientation on mechanical properties and thermomechanical response of Sn-based solder interconnects	Materials Characterization	2013	第四
Reactive wetting of Sn0.7Cu-xZn lead-free solders on Cu substrate	Journal of Alloys and Compounds	2007	第三
Reactive wetting of solders on Cu and Cu6Sn5/Cu3Sn/Cu substrates using wetting balance	Scripta Materialia	2006	第三
Depressing effect of 0.2wt% Zn addition into Sn-3.0Ag-0.5Cu solder alloy on the intermetallic growth with Cu substrate during isothermal aging	Journal of Electronic Materials	2006	第四
Sn concentration on the reactive wetting of high-Pb solder on Cu substrate	Materials Chemistry and Physics	2006	第二
Improvement of microstructure and interface structure of eutectic Sn-0.7Cu solder with small amount of Zn addition	Scripta Materialia	2005	第二
Rate-dependent indentation behavior of solder alloys	Journal of Materials Science	2005	第二
Indentation rate-dependent creep behavior of Sn-Ag-Cu Pb-free Ball grid array (BGA) solder joint	Materials Science Forums	20005	第二
Residual clad formation and aluminum brazed joint topology prediction	Materials Letters	2005	第四

Effect of strain rate on Lüders band propagating velocity and Lüders strain for annealed mild steel under uniaxial tension	Materials Letters	2003	第四
Development of Cu-Sn intermetallic compound at Pb-free solder/Cu joint interface	Materials Letters	2003	第一
Finite element simulation on the propagation of Luders band and effect of stress concentration	Materials Letters	2003	第三
Numerical Simulation on Shear Stress Distribution in as-soldered Al-Al ₂ O ₃ Assembly	Science and Technology of Welding and Joining	2003	第一
Rate-dependent indentation hardness of a power-law creep solder alloy	Applied Physics Letters	2003	第一
On the loading curve in microindentation of viscoplastic solder alloy	Materials Science and Engineering A	2003	第一
Microindentation study on the rate sensitivity of non-homogeneous solder alloy	Journal of Materials Science Letters	2002	第一
The stress field characteristics in the surface mount solder joints under temperature cycling: temperature effect and its evaluation	Welding Journal	2002	第二
Interaction relation in 60Sn-Pb-0.05La ternary solder alloy	Materials Letters	2002	第一
Effect of La on the Cu-Sn IMC growth and solder joint reliability	Journal of Alloys and Compounds	2002	第一
Strengthening Sn60-Pb40 Solder Alloy by Adding Trace Amount of La	Materials Letters	2002	第一
Effect of La on the Sn-rich halo formation in Sn60-Pb40 alloy	Journal of Alloys and Compounds	2001	第一
Prediction for Uniaxial Mechanical Response of SnPb Eutectic Alloy	Journal of the Japanese High Temperature Society	1999	第三
具有抗氧化能力的无铅焊料	中国发明专利 ZL 03 1 10895.4		
无铅软钎焊料合金	中国发明专利 ZL 2006 1 0151104.8		
纳米增强无铅焊料的制备方法	中国发明专利 ZL 2009 1 0306035.7		
无卤素环保型清洗剂	中国发明专利 ZL 2008 1 0216141.1		
细线径无铅焊锡丝的加工方法	中国发明专利 ZL 2008 1 0066553.1		

一种铝软钎焊用抗腐蚀及抗氧化无铅焊料合金的生产方法	中国发明专利 ZL 201010194371.X		
有芯焊丝生产中连续检测助焊剂的方法和设备	中国发明专利 ZL 201010254558.4		
环保型三防漆	中国发明专利 ZL 201210252586.1		
具有高延展性的耐腐蚀LED焊料合金	中国发明专利 ZL 201210229471.0		
具有高延展性的耐腐蚀高温焊料	中国发明专利 ZL 201210229477.8		
具有高延展性的低银无铅锡膏焊料	中国发明专利 ZL 201210229494.1		
具有耐腐蚀的高强度高温焊料	中国发明专利 ZL 201210229474.4		
一种锡膏包装设备	中国发明专利 ZL 201210076111.1		
一种复合无铅钎料制备过程中添加微量元素的方法	中国发明专利 ZL 201310284406.2		
一种具备尺寸效应的纳米级/微米级颗粒混合型无铅焊料膏及其制备方法	中国发明专利 ZL 201310646155.8		
一种单一取向Cu ₆ Sn ₅ 金属间化合物微互连焊点结构的制备及应用方法	中国发明专利 ZL 201310648319.0		
一种局部强化的高可靠性钎料及其制备方法	中国发明专利 ZL 201310207421.7		
一种太阳能光伏组件用助焊剂及其制备方法	中国发明专利 ZL 201510259268.1		
一种无铅锡膏用活性剂及其制备方法及一种无铅锡膏	中国发明专利 ZL 201410396771.7		
一种可形成均匀组织焊点的无铅焊料及其焊接方法	中国发明专利 ZL 201410296364.9		
一种面阵列的封装方法	中国发明专利 ZL 201710472517.4		
用于面阵列封装用铜基非晶焊球及其制备方法及封装方法	中国发明专利 ZL 201710442433.6		
一种纳米锡铋复合焊膏及制备方法	中国发明专利 ZL 201711084347.9		
一种锡铋复合合金及其制备方法	中国发明专利 ZL 201810322515.1		
《无铅钎料》	中国国家标准 GB/T 20422-2006		第二
《钎焊接头强度试验方法》	中国国家标准 GB/T 11363-2008		第二
《钎料润湿性试验方法》	中国国家标准		第二

《软钎剂 分类与性能要求》	GB/T 11364-2008 中国国家标准		第一
《软钎料试验方法》	GB/T 15829-2008 中国国家标准		第二
《钎焊术语》	GB/T 28770-2012 中国国家标准		第三
《无铅钎料》	GB/T 33148-2016 中国国家标准		第三
《软钎剂试验方法 第1部分：不挥发物质含量的测定 重量法》	GB/T 20422-2018 中国国家标准		第七
《软钎剂试验方法 第10部分：软钎剂润湿性能 铺展试验方法》	GB/T 38265.1-2019 中国国家标准		第八
《软钎剂试验方法 第16部分：软钎剂润湿性能 润湿平衡法》	GB/T 38265.10-2019 中国国家标准 GB/T 38265.16-2019		第一

主要业绩（论著、科研项目、科研成果、奖励等）			
名称	发表刊物、项目来源	时间	本人位次

所在单位人事（或组织）部门负责人签字：



公章： 年 月 日

学院学位评定分委员会评议、推荐意见

主席签字：

公章： 年 月 日